

2013年3月期 中間決算説明会

2012年11月1日

東京エレクトロン デバイス株式会社



東京エレクトロン デバイス株式会社

決算報告

代表取締役副社長

久我 宣之

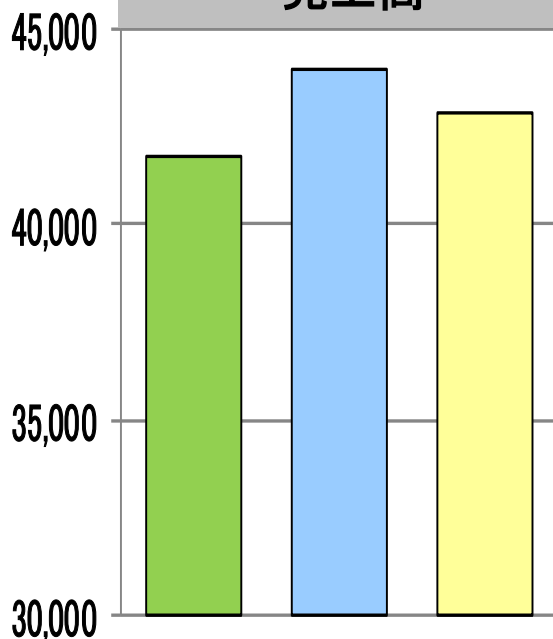
連結業績－1

(単位:百万円)

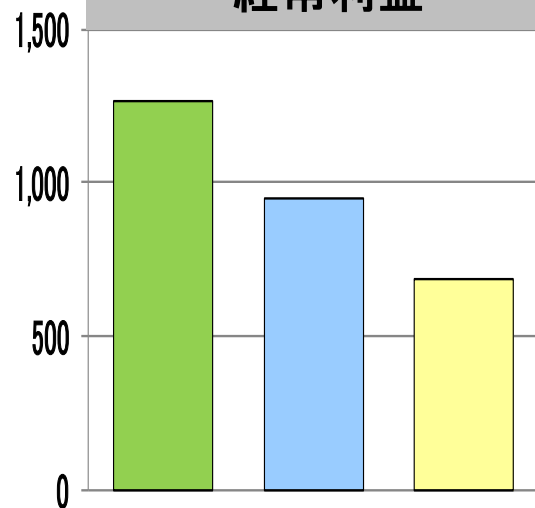
	2012年3月期 中間		2013年3月期 中間		増減額	増減率 (%)
		百分比 (%)		百分比 (%)		
売上高	41,787	100.0	42,866	100.0	1,079	2.6
売上総利益	7,322	17.5	7,286	17.0	▲36	▲0.5
営業利益	822	2.0	688	1.6	▲134	▲16.3
経常利益	1,263	3.0	686	1.6	▲577	▲45.7
中間純利益	699	1.7	406	0.9	▲292	▲41.9
1株当たり 中間純利益	6,595円43銭		3,833円66銭			
従業員数	906名		954名			

連結業績 - 2

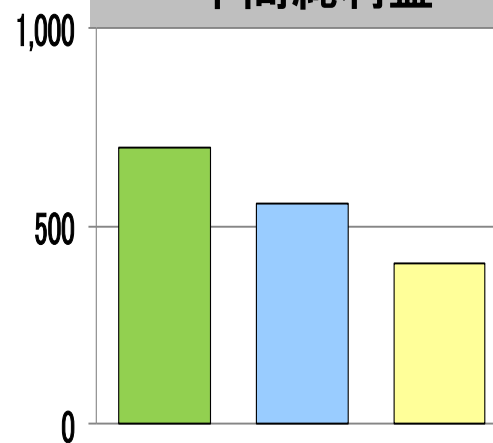
売上高



経常利益



中間純利益



■ 前期中間
■ 年初中間予想
■ 今期中間

単位: 百万円	前期中間	年初中間予想	今期中間	前年比(%)	予想比(%)
売上高	41,787	44,000	42,866	2.6	▲2.6
経常利益	1,263	950	686	▲45.7	▲27.8
中間純利益	699	560	406	▲41.9	▲27.4

連結業績 — 3

(単位: 百万円)

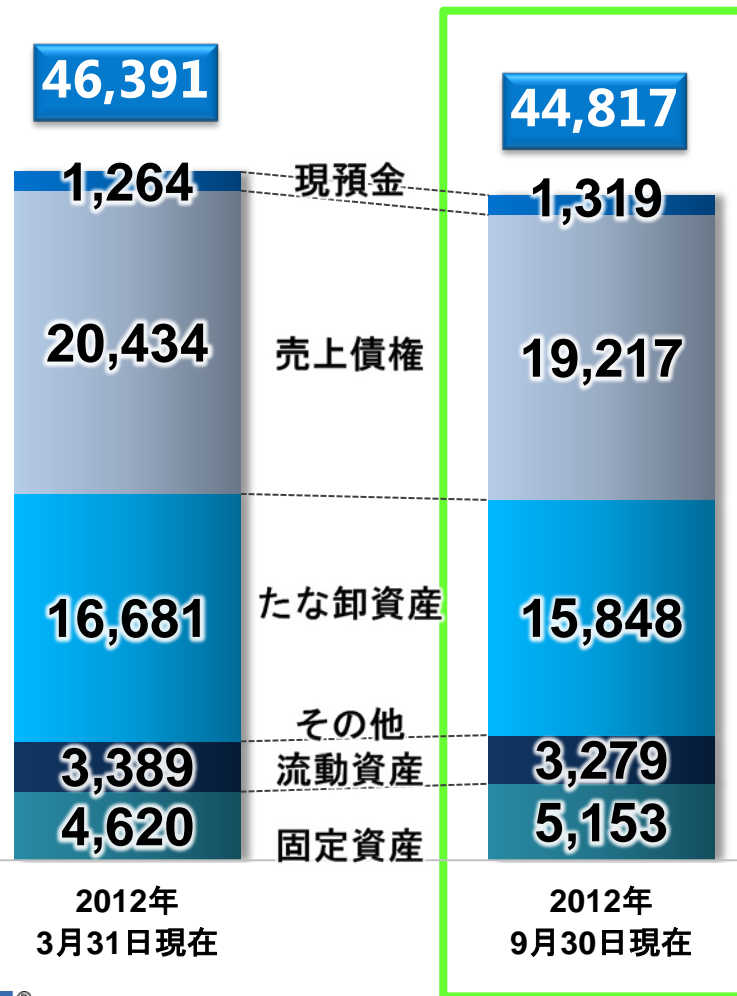
セグメント	2012年3月期中間		2013年3月期中間				(参考) 年初中間 予想売上高
	売上高	セグメント 利益	売上高	増減額 増減率	セグメント 利益	増減額 増減率	
半導体及び 電子デバイス	35,059	525	35,899	840 2.4%	212	▲312 ▲59.5%	37,055
コンピュータ システム関連	6,728	738	6,966	238 3.5%	473	▲265 ▲35.9%	6,945
合計	41,787	1,263	42,866	1,079 2.6%	686	▲577 ▲45.7%	44,000

* 取引形態の類似性を踏まえ「コンピュータシステム関連事業」が取り扱っていた組み込み機器向けソフトウェア等を「半導体及び電子デバイス事業」に移管しております。

連結総資産・負債・純資産

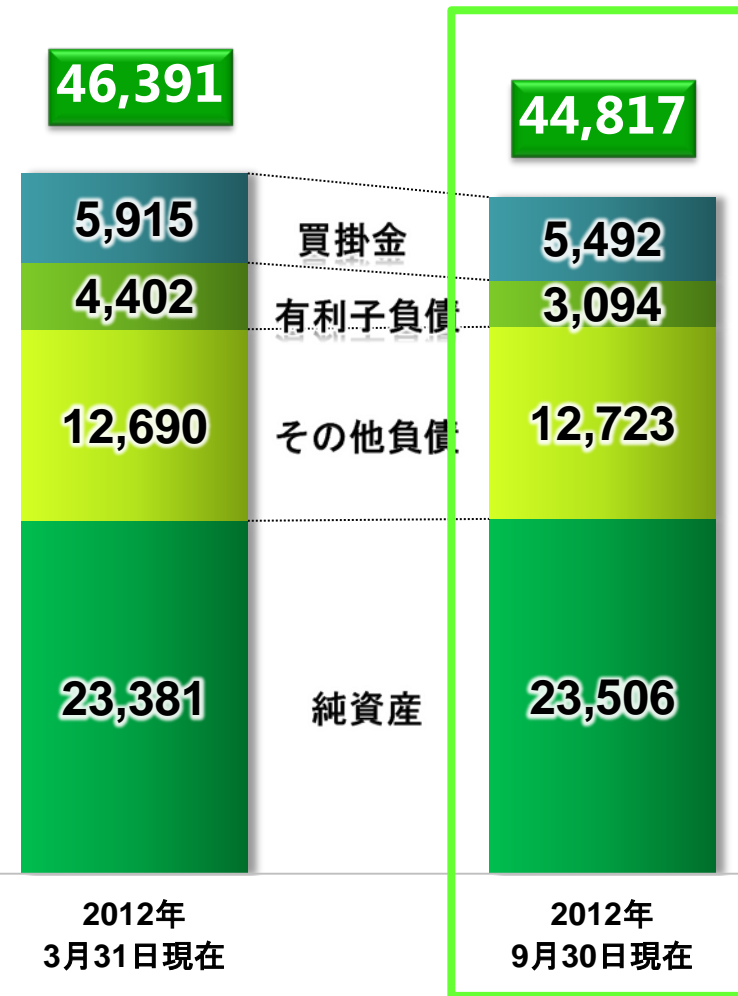
資産

(単位:百万円)



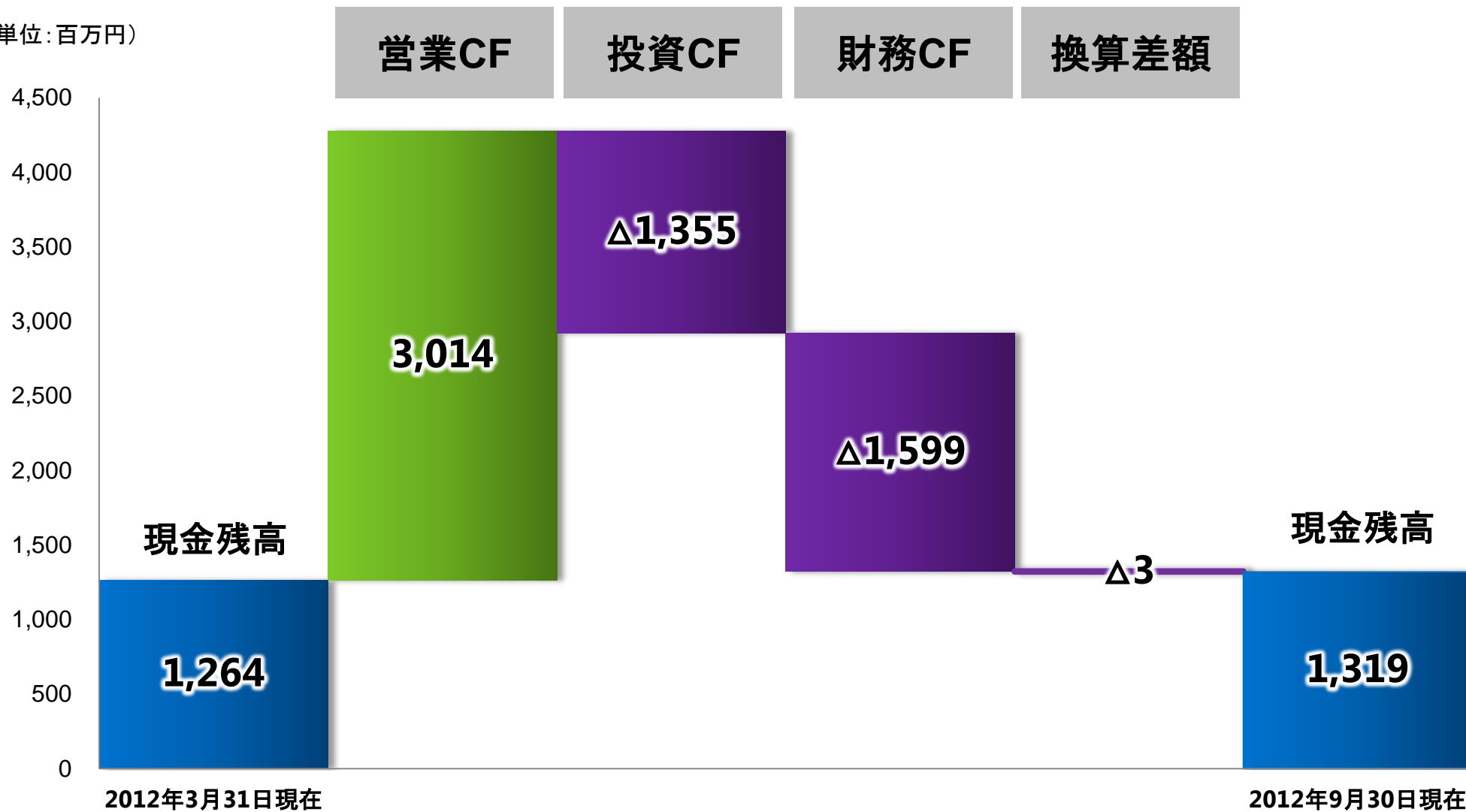
負債・純資産

(単位:百万円)

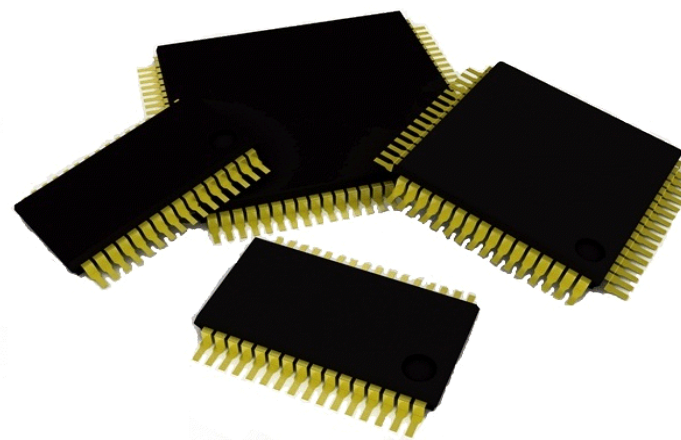


連結キャッシュ・フロー

(単位:百万円)



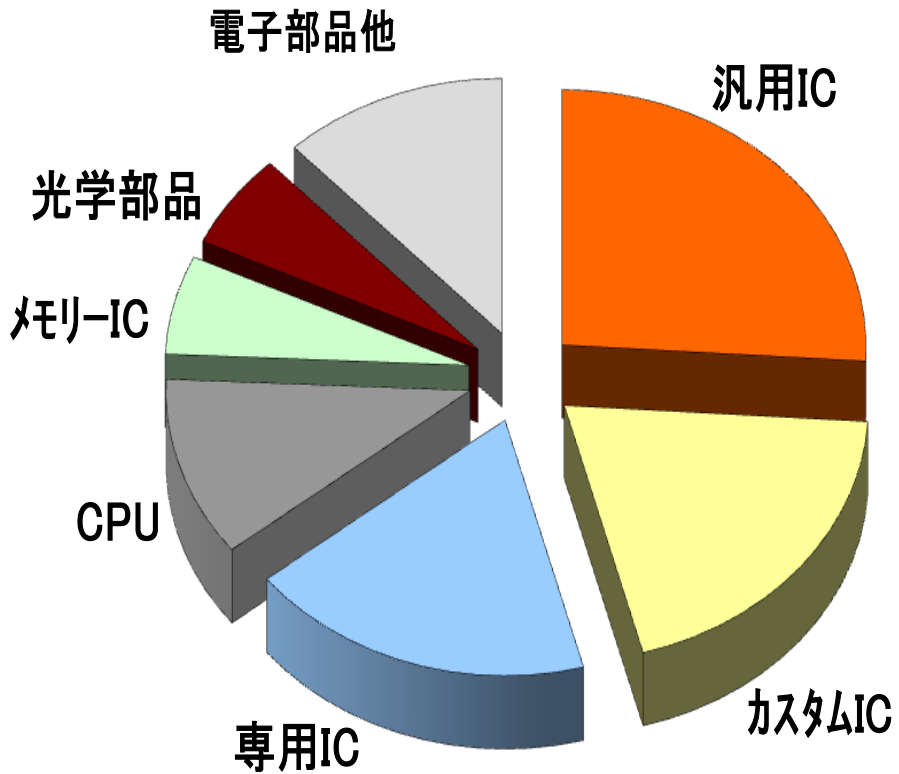
半導体及び電子デバイス事業



品目別 売上構成

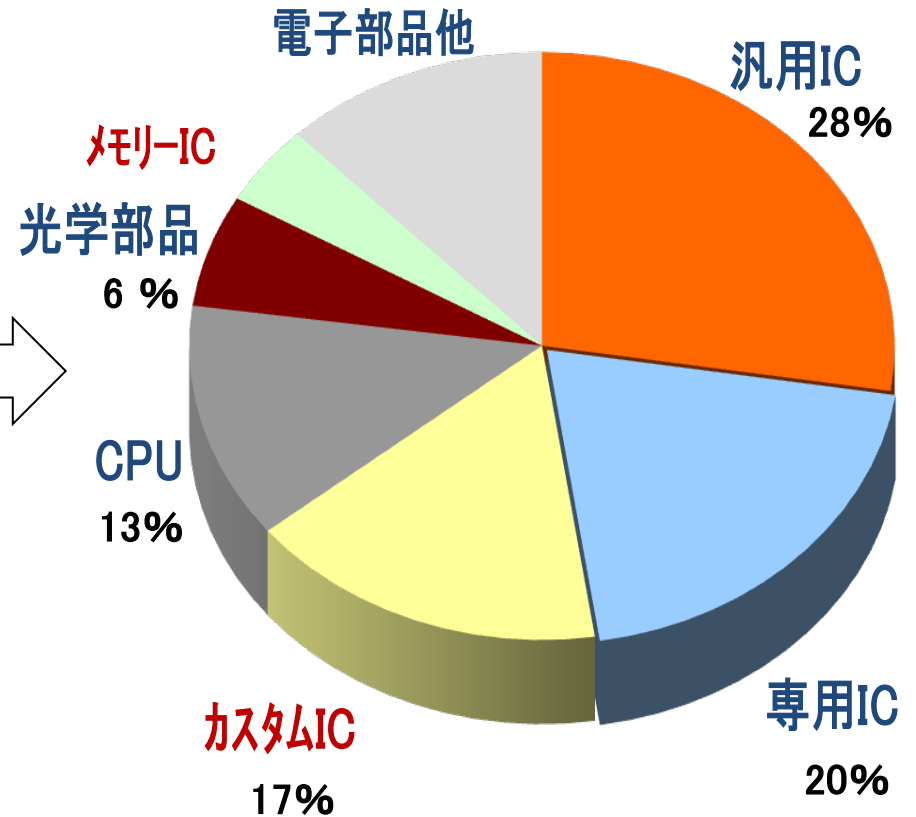
【 2012年中間 内訳 】

売上高： 35,059百万円



【 2013年中間 内訳 】

売上高： 35,899百万円



* 品目についての説明は、P.38～ P.40をご参照ください。

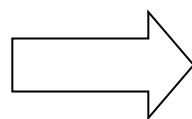
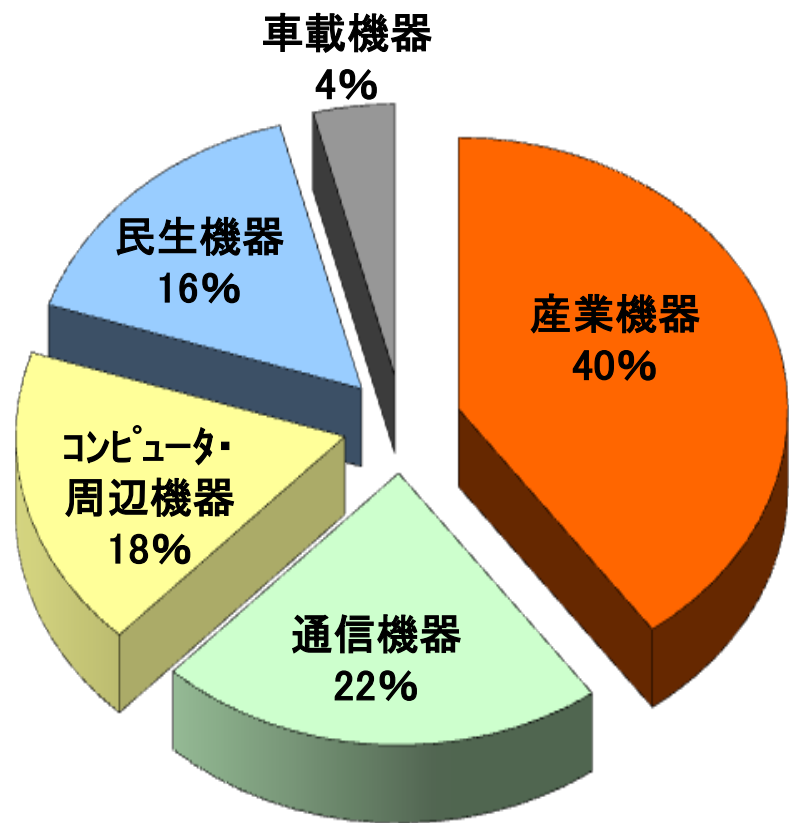
品目別 売上増減

主な品目	主な仕入れ先	対前年増減率	主な要因
汎用IC	TI、リニアテクノロジー	8%	産業機器低調も商権拡大により増加
専用IC	TI、ピクセルワークス、ピクシス、インターシル、メモック、リアルテック、インレピアム	12%	複合プリンタ、液晶プロジェクタ等PC周辺機器や民生機器が商権拡大により増加
カスタムIC	ザイリンクス、富士通	▲15%	産業機器、民生機器向け減少
CPU	TI、フリースケール、インテル	17%	商権拡大により増加
光学部品	アバゴ・テクノロジー	1%	スマートフォン向け増加

注) 社名は、敬称を省略し略称を使用させていただいております。

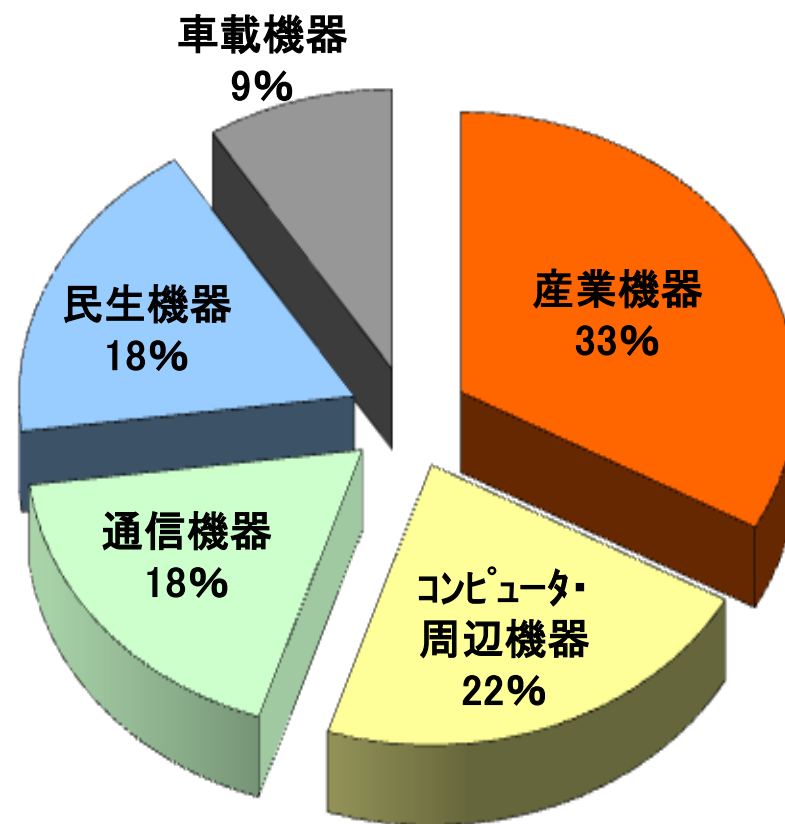
【 2012年中間 内訳 】

売上高： 35,059百万円



【 2013年中間 内訳 】

売上高： 35,899百万円



用途別 傾向

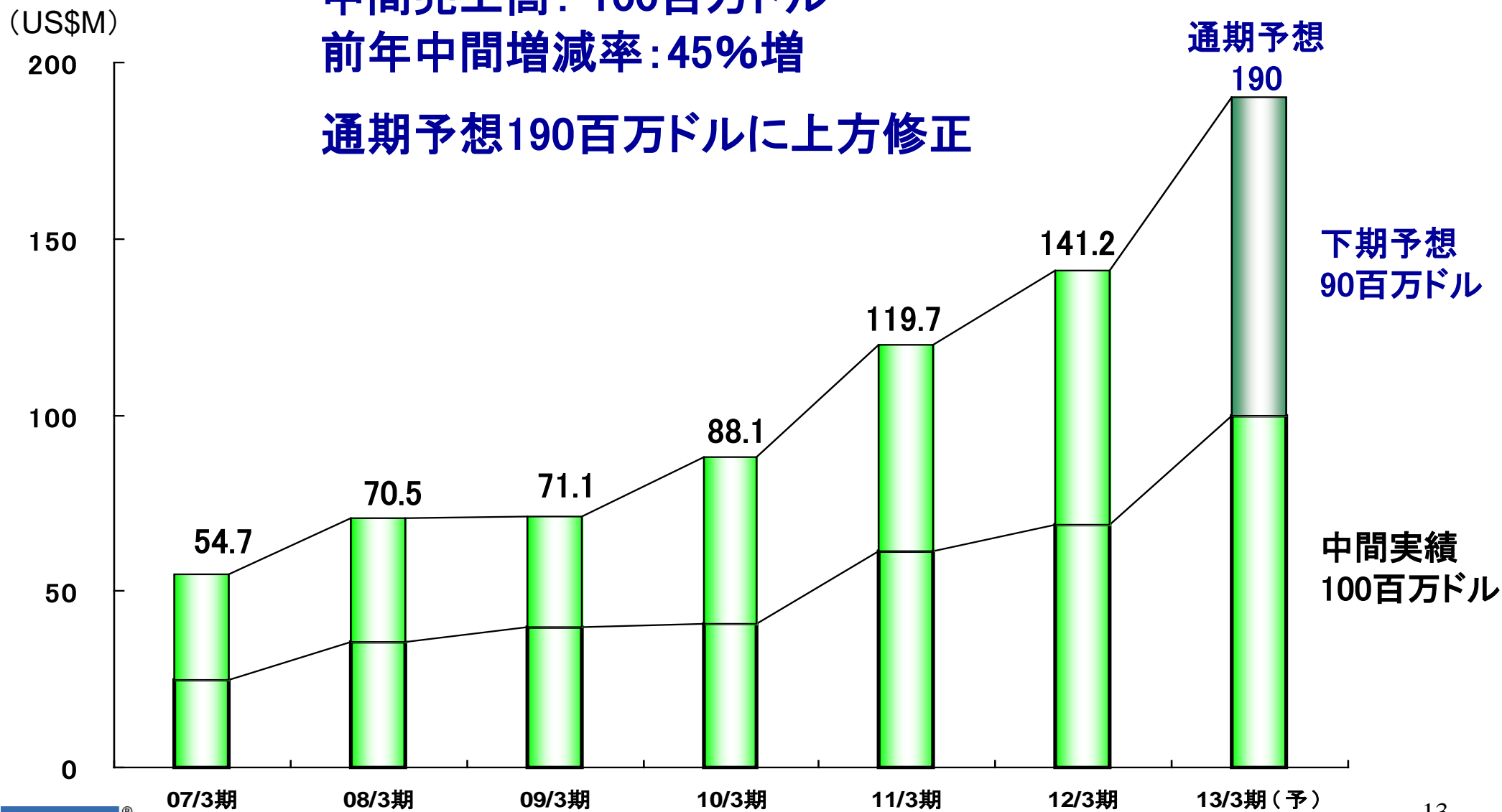
用途	主なアプリケーション	当社の傾向
産業機器	医療機器、放送機器、テスター、ロボット、半導体製造装置、計測器、工作機械	全般的に低調
コンピュータ・周辺機器	複合プリンター、液晶プロジェクタ、PC及び付属機器	液晶プロジェクタ、複合プリンターが商権拡大により増加
通信機器	携帯電話、スマートフォン、携帯端末ルーター、伝送装置、基地局	携帯端末系は総じて低調の中、スマートフォン向け光学部品のみ堅調 基地局はやや回復傾向
民生機器	デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、TV、AV機器、家庭用ゲーム	TV低調も デジタルカメラ、家庭用ゲームは増加
車載機器	カーナビゲーション、カーオーディオ	カーナビゲーションが商権拡大により大幅増加

海外連結子会社売上高推移

中間売上高: 100百万ドル

前年中間増減率: 45%増

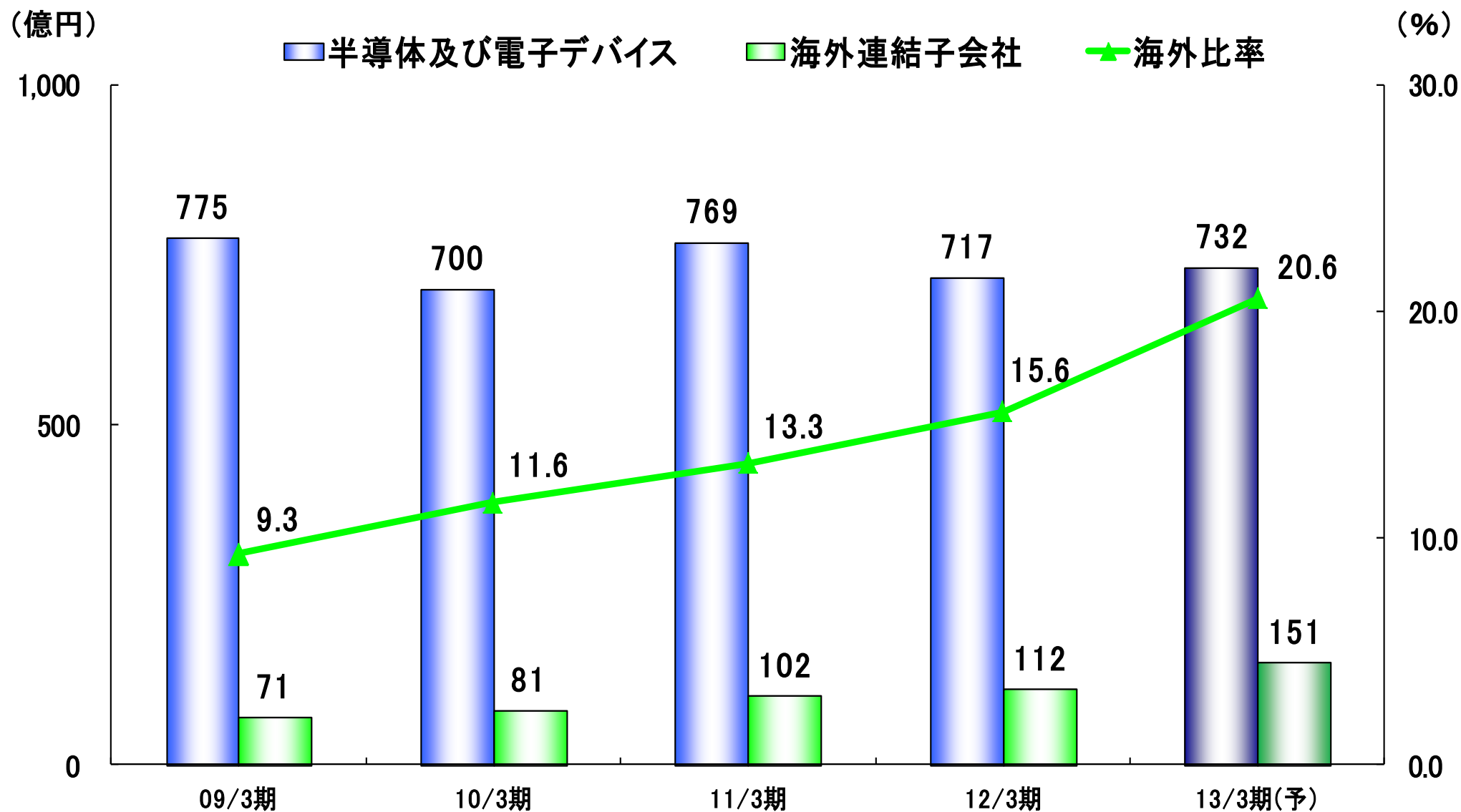
通期予想190百万ドルに上方修正



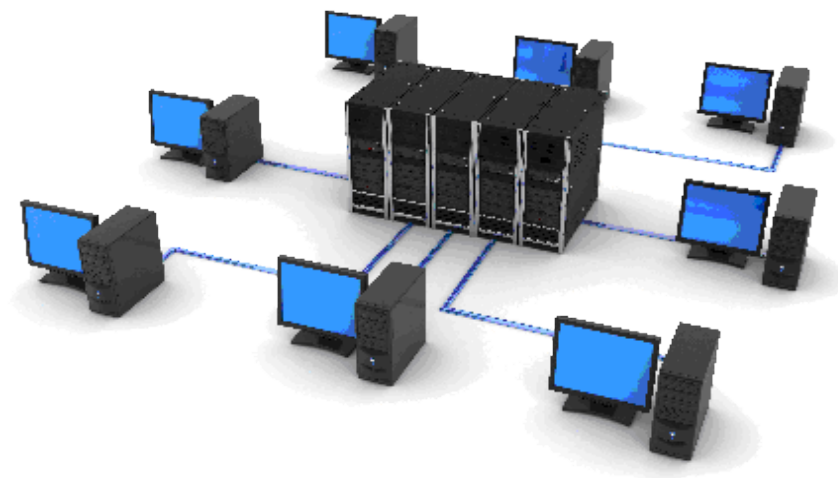
下期予想
90百万ドル

中間実績
100百万ドル

売上高及び海外子会社売上高

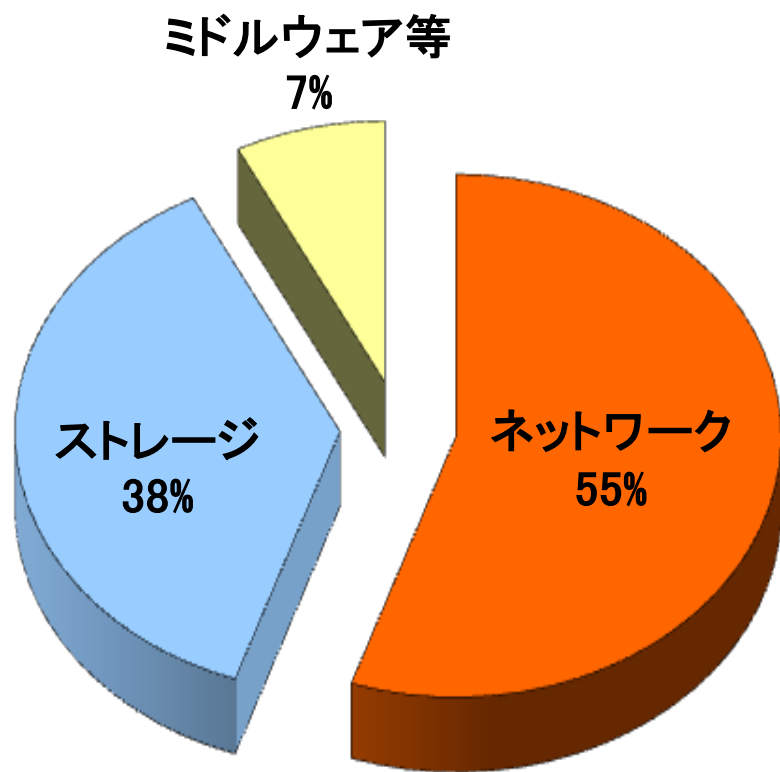


コンピュータシステム関連事業



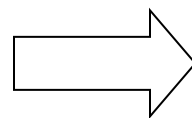
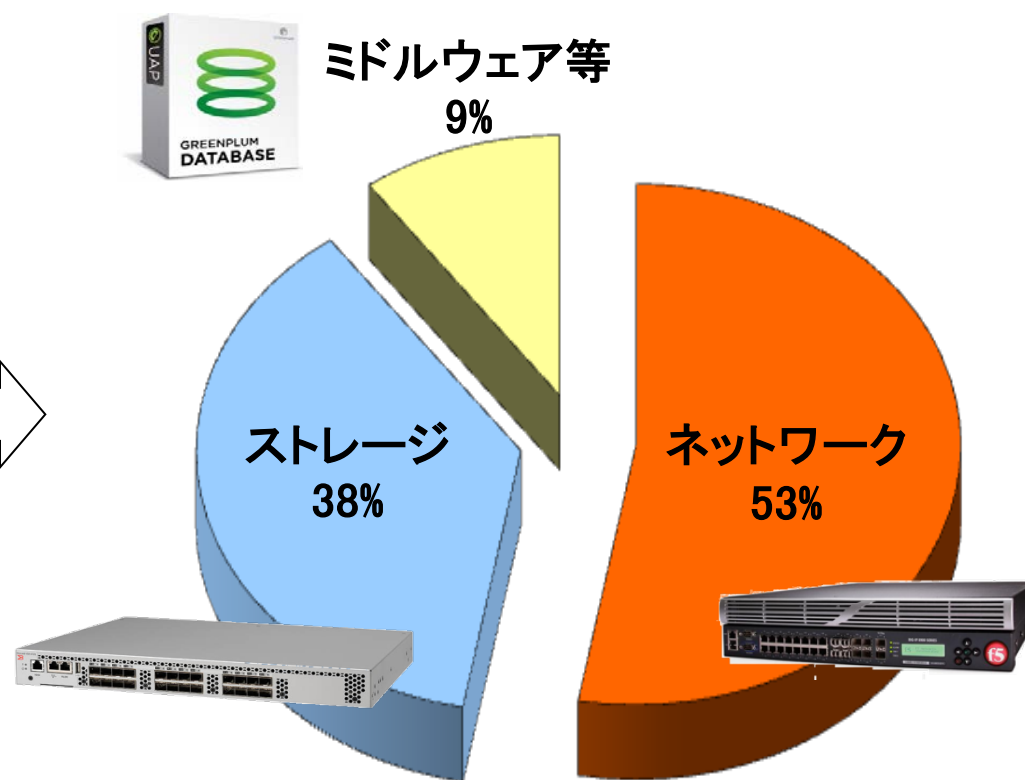
【 2012年中間 内訳 】

売上高：6,728百万円



【 2013年中間 内訳 】

売上高：6,966百万円

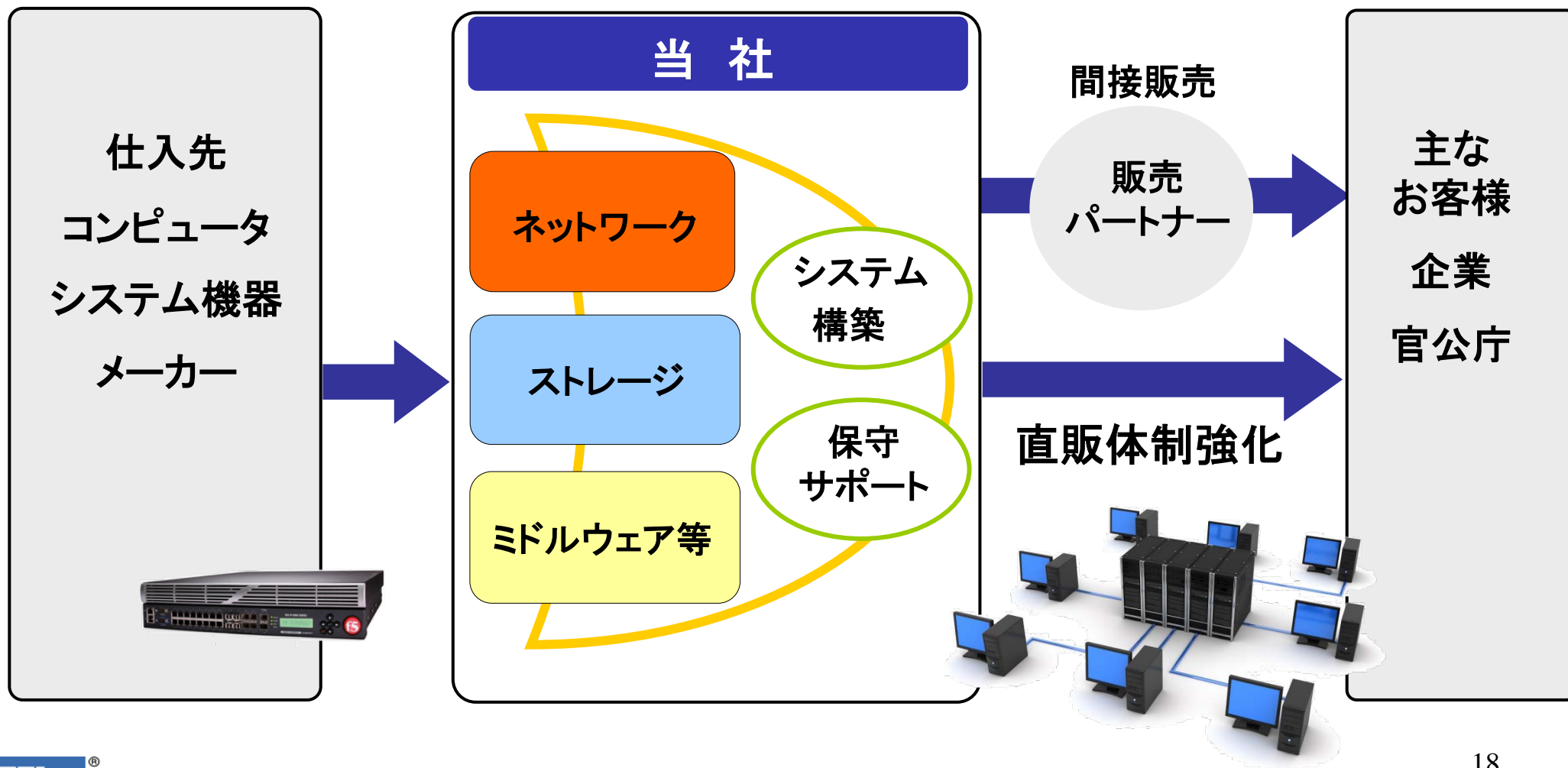


品目別売上増減要因

主な品目	主な仕入れ先	対前年増減率	主な要因
ネットワーク関連	F5ネットワークス	0.2%	企業向け製品販売やや低調、保守堅調
ストレージ関連	ブロード、EMC	3%	データセンター向けIT投資増加
ミドルウェア等	EMC、オラクル	32%	企業向けデータ分析ソフトウェア堅調

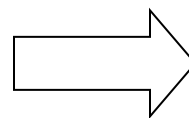
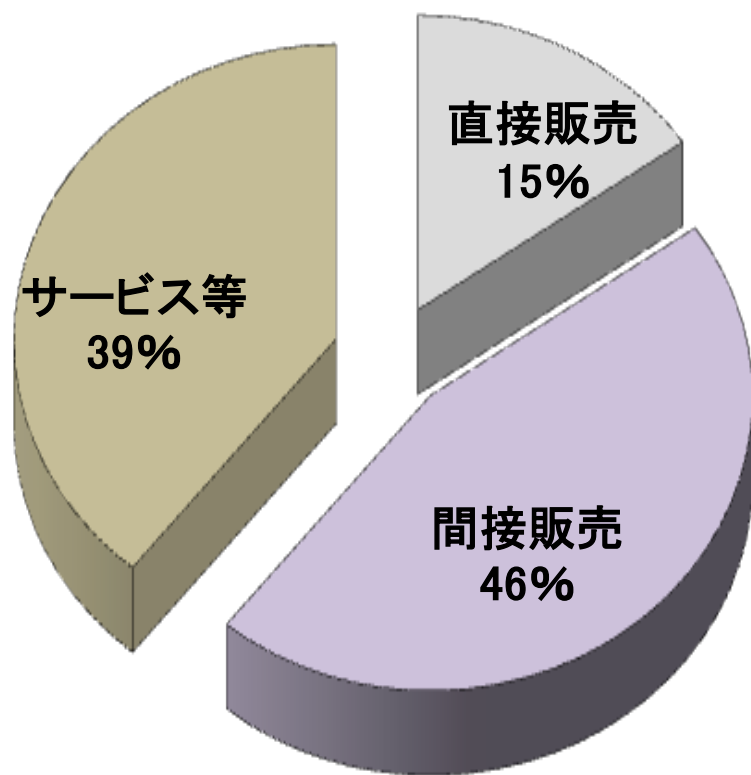
注)社名は、敬称を省略し略称を使用させていただいております。

◆ 直販体制を強化



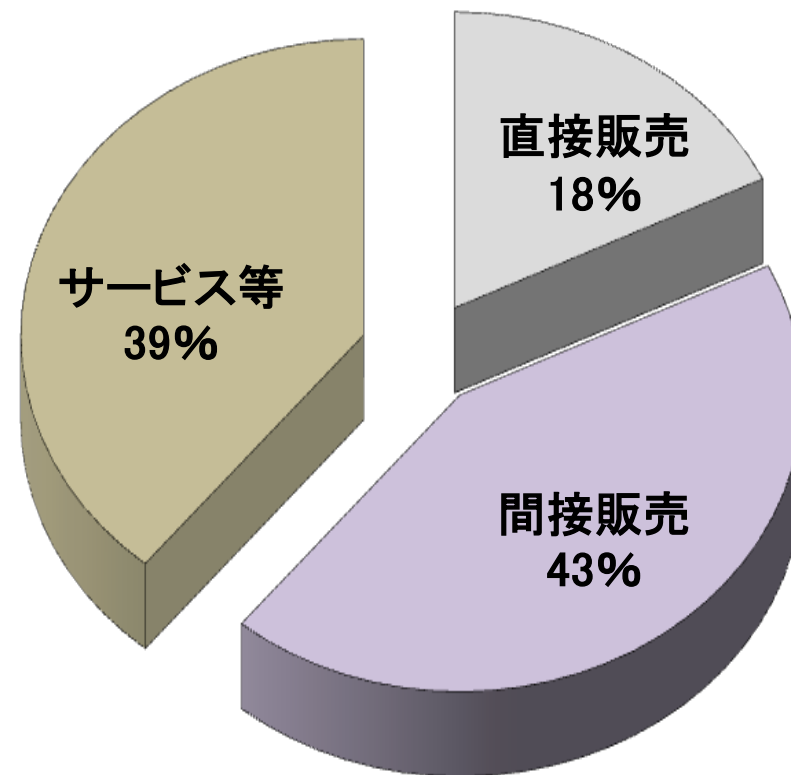
【 2012年中間 内訳 】


売上高：6,728百万円



【 2013年中間 内訳 】

売上高：6,966百万円



- 
- ・ 2013年3月期中間レビュー
 - ・ 2013年3月期業績見込み
 - ・ 配当について

代表取締役社長

栗木 康幸

2013年3月期中間レビュー

経営ビジョン

1. お客様、仕入先から絶対的な信頼を得るNo.1技術商社を目指す
2. 企業倫理の徹底
3. 次世代を担う商材と人材の創出
4. 海外事業の促進
5. 新事業への継続的な投資

利益を出し続け拡大していく

株主様への還元

社員の幸福

社会への貢献

お客様の信頼

成長戦略 新商材

日付	メーカー名	主な内容
2012年10月	Cypress社(半導体)	Psoc、USBコントローラ、SRAM
2012年4月	Digi international社(半導体)	M2M向けワイヤレスモジュール
2012年2月	Realtek社(半導体)	PC、プリンタなどのネットワーク向けIC
2012年1月	Micropelt社(新事業)	温度差発電型環境発電
2011年7月	Powercast社(新事業)	電波から環境発電
2011年7月	Nicira Networks社(コンピュータシステム)	ネットワーク仮想化ソフトウェア
2011年1月	Fusion-io社(コンピュータシステム)	ストレージ製品
2010年12月	Memsic社(半導体)	MEMSセンサ
2010年10月	Semikron社(半導体)	パワー半導体

成長戦略 海外事業-1

◆ 半導体及び電子デバイス事業の 売上高海外比率30%を目指す

● アジア地域への販売促進

日系お客様の現地工場

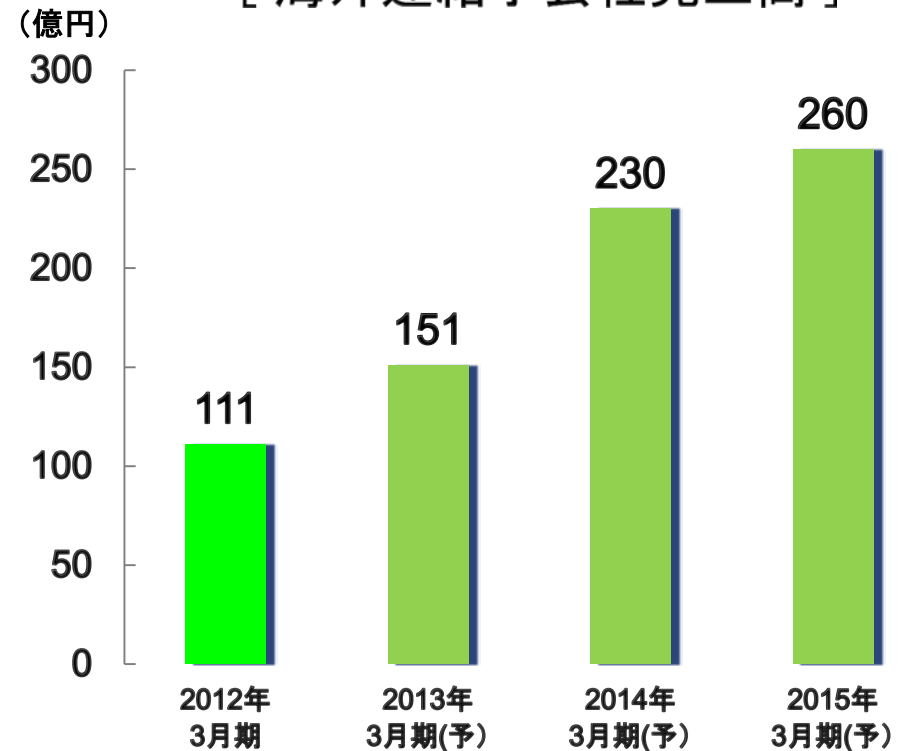
お客様の製造委託先企業

海外現地企業

● 自社ブランド商品の海外展開加速

inrevium

[海外連結子会社売上高]



成長戦略 海外事業-2

◆香港にアジア本社を設置(オペレーションを一元化)



駐在員

- ・シリコンバレー
- ・イギリス

● 営業拠点

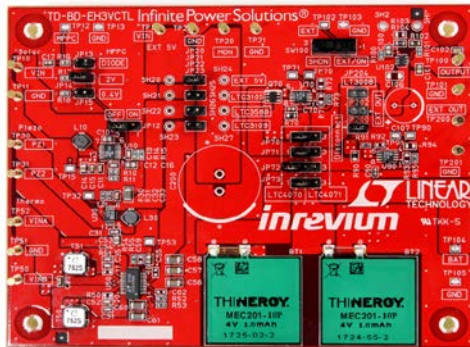
● 設計開発拠点

◆ 環境発電(エネルギーハーベスト)関連評価ボードを2種類開発

- 環境発電機器の開発期間短縮や開発費削減に効果
- 当社取扱いIPS社全固体リチウム電池を搭載
- インレビウムブランドで提供

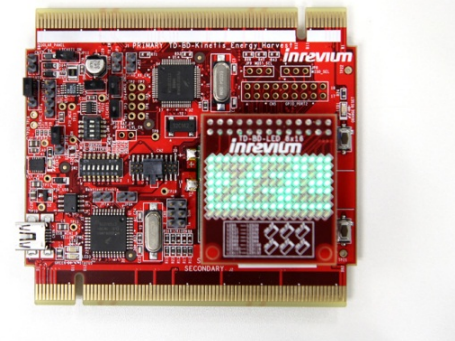


【 環境発電アプリケーション開発ボード 】



- 生活住環境エネルギーから蓄発電可能
- リニアテクノロジー社環境発電ICを搭載

【 環境発電向けCPU評価ボード 】



- 微弱な電力で動くモーターやセンサーの開発用
- フリースケール・セミコンダクタ社マイコン搭載

売上に至るまでの道のり

売上

最終製品の競争力

お客様が勝てる価値を提案
+
従来の当社付加価値

0~5

デザインウイン
10

1年前

• 当社商品の採用決定

オポチュニティ
20~50

2~3
年前

• 開発案件の発掘
• 仕様に合わせた商品の提案

デマンドクリエーション
100~200

3~5
年前

• 市場調査
• 商品の提案及びヒアリング

販売活動

【商談件数イメージ】

【時間軸】

【内容】

電子部品 競合商品の取り扱い

【過去】

サプライヤー	CPU	メモリー	アナログ	ロジック
A社	○			
B社		○		○
C社			○	
D社			○	



サプライヤーの事業領域拡大、M&A等+新規サプライヤー

【現在】

サプライヤー	CPU	メモリー	アナログ	ロジック
A社	○	○		○
B社	○	○	○	○
C社			○	○
D社			○	
新規	○	○		○

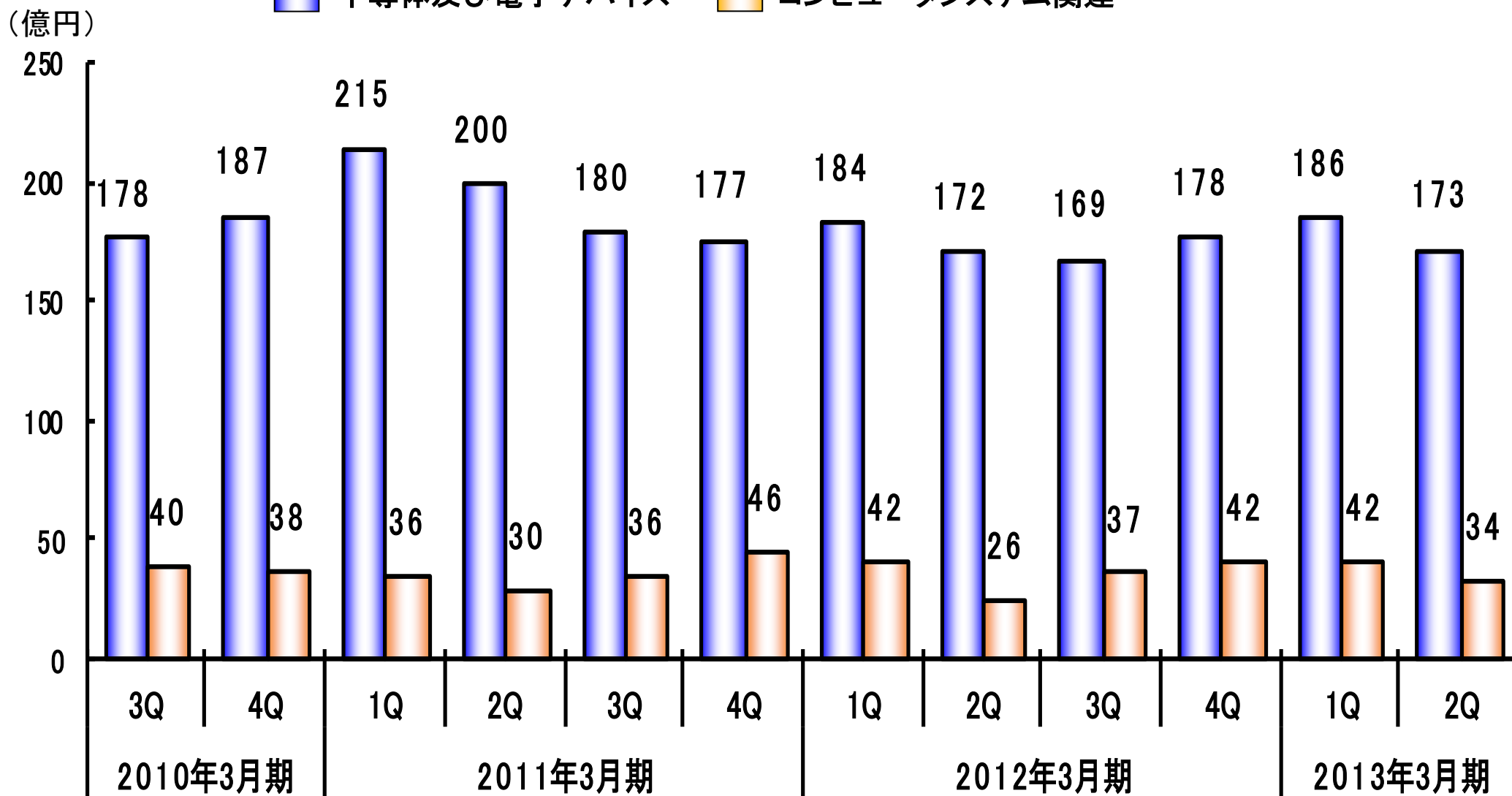
- ◆ 分社化
- ◆ 当社企業ブランド

* 表はイメージです。

2013年3月期業績見込み

受注高推移

■ 半導体及び電子デバイス ■ コンピュータシステム関連



【半導体及び電子デバイス事業】

- ・ 上期：産業機器向けの需要が想定より低調。
- ・ 下期：回復シナリオが、不透明感。

商権移管寄与も年初想定より遅れる見込み。

【コンピュータシステム関連事業】

- ・ 上期：クラウドやデータセンター向けが堅調。
- ・ 下期：官公庁向け等下期の需要増を想定。

セグメント別 連結売上高予想

(単位:百万円)

	前期実績	年初予想	中間実績	下期予想	通期予想	前期増減額 増減率	年初予想増減額 増減率
半導体及び電子デバイス	71,780	82,281	35,899	37,370	73,270	1,490 2.1%	▲9,011 ▲11.0%
コンピュータシステム関連	14,520	15,719	6,966	8,764	15,730	1,210 8.3%	11 0.1%
合計	86,300	98,000	42,866	46,134	89,000	2,700 3.1%	▲9,000 ▲9.2%

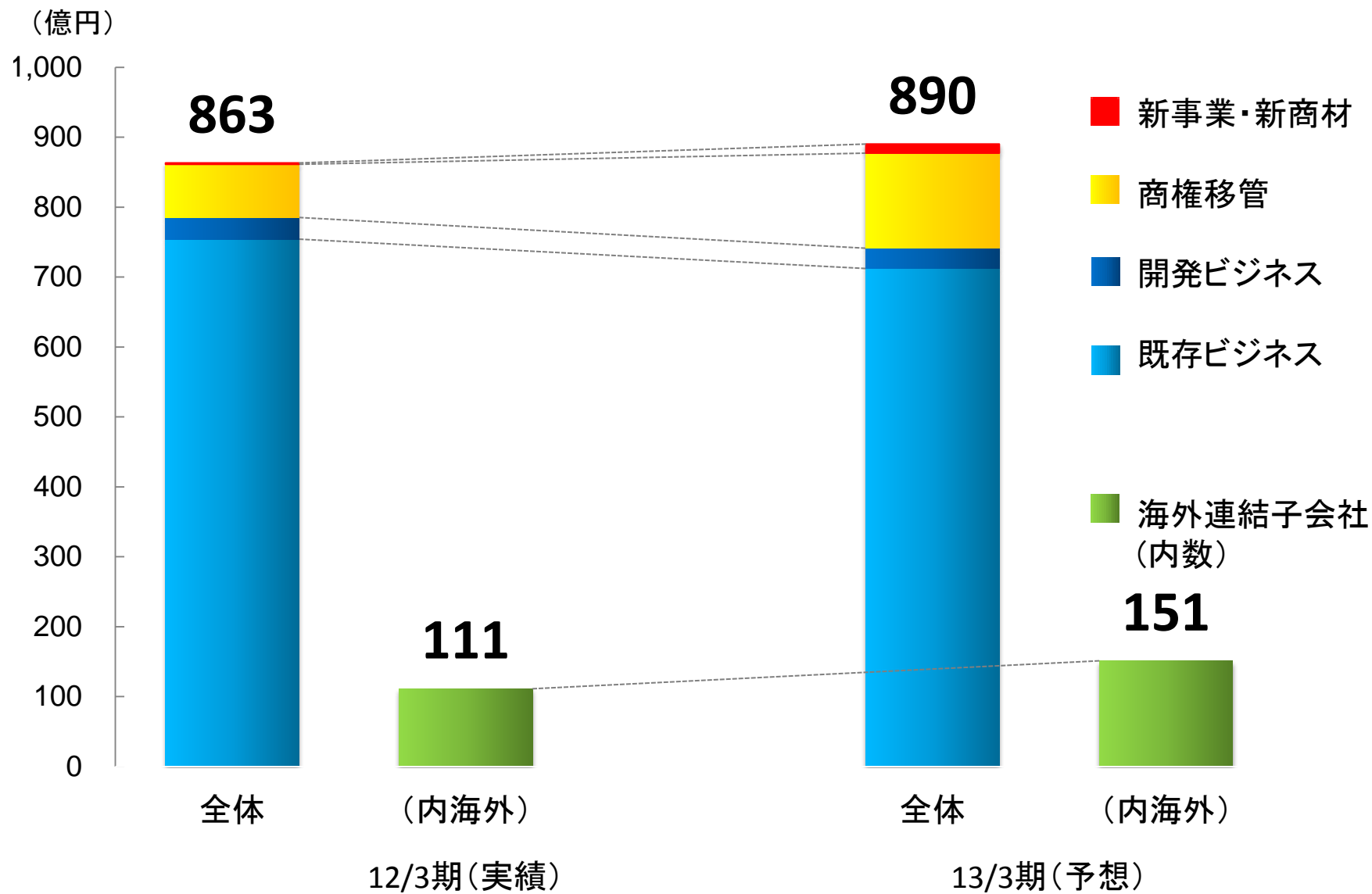
2013年3月期 連結業績予想

(単位:百万円)

	前期実績	年初予想	中間実績	下期予想	通期予想	前期増減額 増減率	年初予想増減額 増減率
売上高	86,300	98,000	42,866	46,134	89,000	2,700 3.1%	▲9,000 ▲9.2%
経常利益	2,332	2,700	686	864	1,550	* ▲782 ▲33.6%	▲1,150 ▲42.6%
当期純利益	960	1,650	406	514	920	▲40 ▲4.2%	▲730 ▲44.2%

* 商品構成の変化
新商材開拓の為の経費
為替差損益
償却債権取立益差額

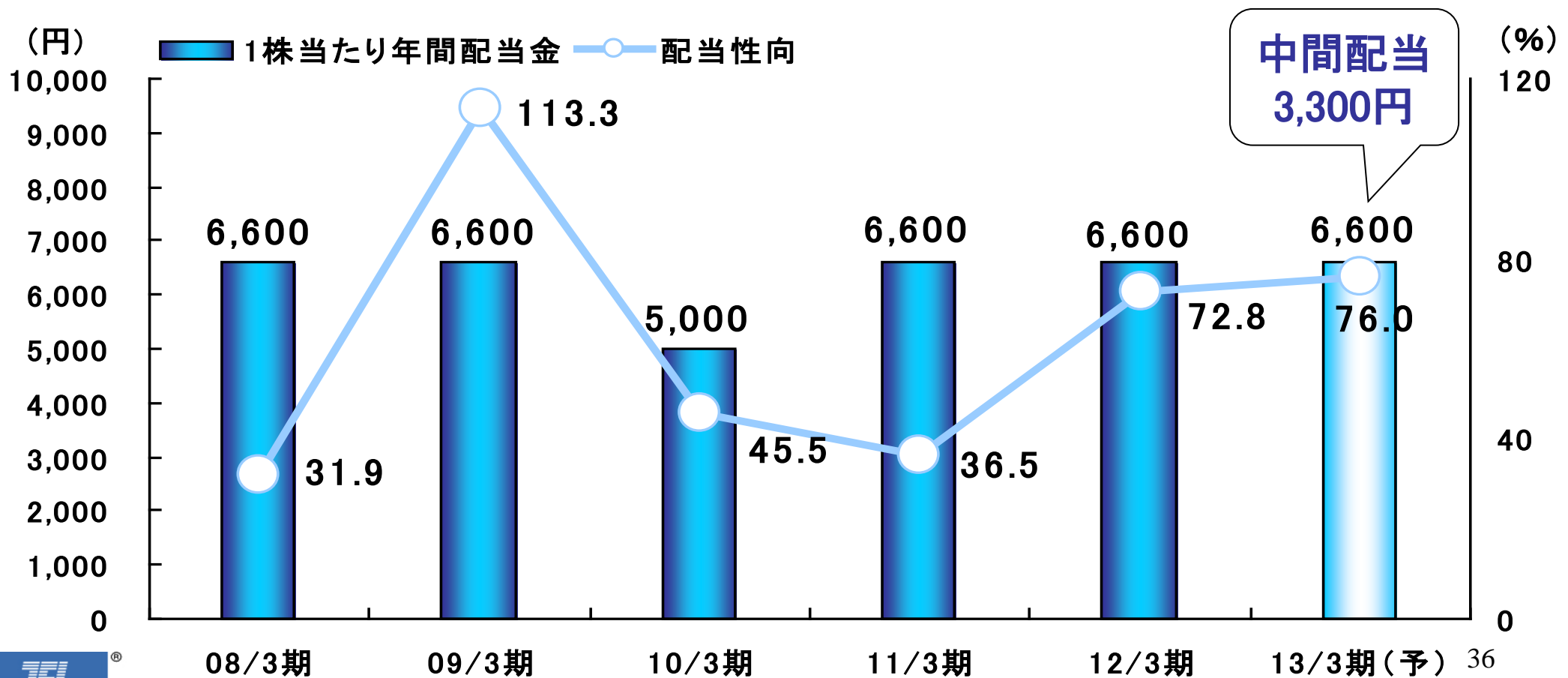
連結売上高予想 内訳



配当について

配当について

- ◆ 継続的かつ安定的な配当の実施を基本として、業績を反映した適正な利益還元を原則
- ◆ 当面の配当性向水準：連結当期純利益の35%程度を目安



資料取扱い上の注意




このプレゼンテーションで述べられている将来の当社事業に関する見通しは、現時点で知りうる情報をもとに構築されたものです。

当社の参画するエレクトロニクス業界及びIT業界は変化のスピードが大変速く、また、世界経済、半導体市況など、当社の業績に直接的・間接的に影響を与える様々な外部要因があります。

したがって、今後当社の業績見通しが本プレゼンテーションと異なる可能性があることをお含みおきください。また、大きな変更がある場合は、その都度発表していく所存です。

セグメント・品目		主な仕入先名
半導体及び 電子デバイス 事業	汎用IC	リニアテクノロジー社、TI 社
	専用IC	コネクサントシステムズ社、フリースケール・セミコンダクタ社、富士通セミコンダクター(株)、インターシル社、メモシック社、ピクセルワークス社、リアルテック・セミコンダクター社、シリコンイメージ社、 TI社、ビクシシステムズ社、インビーム
	カスタムIC	富士通セミコンダクター(株)、サイリンクス社、インビーム
	CPU	フリースケール・セミコンダクタ社、富士通セミコンダクター(株)、インテル社、TI 社
	光学部品	アバゴ・テクノロジー社
	メモリーIC	IDT社、ラムトロンインターナショナル社、スパンション社
	電子部品他	コーセル(株)、マイクロソフト社、インビーム
コンピュータシステム 関連事業	ネットワーク機器	エクストリームネットワークス社、F5ネットワークス社
	ストレージ関連	ブロード社、EMC社
	ミドルウェア等	EMC社、オラクル社

品目	主な取扱商品	機能
汎用IC	汎用リアIC(アナログIC) 汎用ロジックIC	色々な用途に共通に使用されるIC
専用IC	画像処理用IC 通信用・ネットワーク用IC	特定用途用に作られた専用IC
カスタムIC	ASIC、PLD	お客様の仕様に応じて作られる固有IC
CPU	マイクロプロセッサ、DSP	電子機器の頭脳、演算機能・制御機能
光学部品	発光ダイオード、フォトカプラ	電気を光に変換して使用する電子部品
メモリーIC	DRAM、SRAM フラッシュメモリ	記憶用IC、書込み、読出しが可能なものや 読出しのみのものがある
電子部品他	ソフトウェア、ボード、 電源、コネクタ	企業向け産業機器に組み込まれるソフトウェア。 プリント配線基板上にIC、電源、コネクタなどの 部品を実装した製品(ボード)

<p>ネットワーク関連</p>		<p>インターネット接続機器(負荷分散、セキュリティ) 企業向けネットワークシステム構築機器。</p>
<p>ストレージ関連</p>		<p>SAN(ストレージエリアネットワーク)スイッチ、 SAN接続機器、ストレージセキュリティ機器など。</p>
<p>ミドルウェア等</p>		<p>データウェアハウス用データベースソフトウェア。 組み込みデータベース</p>